

2026 TPCA 先進趨勢研討會

從高速傳輸到異質整合：AI 驅動下的 PCB 大躍升

AI 發展持續演進,各大雲端 CSP 業者競相投入鉅額資本支出,建構新一代超高算力基礎設施。PCB 與異質整合技術也在這波 AI 基建浪潮中扮演關鍵角色,迎來新一輪需求成長與技術升級。

隨著資料中心架構日益複雜,相關技術挑戰已非單一製程或單一環節所能突破,而需仰賴完整生態系的協同創新。從系統設計、PCB 與載板製造,到材料與設備供應,唯有跨領域整合,才能逐步攻克關鍵技術節點,支撐 AI 時代對高速運算、高速傳輸、高可靠度的需求。

面對技術加速融合的產業趨勢,在 TPCA 半導體構裝委員會、技術委員會的籌備下,匯聚產學研單位第一線專家,邀請 Intel、Prismark、Sony、廣達、群創、臻鼎、欣興、耀華、聯茂、大同大學、工研院等重量級講者,透過兩天完整議程,聚焦四大主軸：

- 6/24 上午 | AI 時代下的 PCB 技術新局
- 6/24 下午 | 高速傳輸挑戰下的 PCB 先進技術發展
- 6/25 上午 | 矽光子異質整合新世代
- 6/25 下午 | 先進封裝下的玻璃基板新戰場

TPCA 年度鉅獻,帶您穿透技術迷霧,洞察 AI 與 PCB 產業的協同演進方向,為下一波成長週期預先布署。

【主辦單位】台灣電路板協會 (TPCA)

【贊助單位】蘇州維嘉科技、長興材料、山東國瓷功能材料、台灣三菱電機自動化、阿托科技
誠摯邀請更多贊助企業夥伴加入!! [點我看贊助方案](#)

【活動時間】2026.06.24 (三)-06.25(四) 09:00-16:30

【活動地點】台灣電路板協會 501 國際會議廳(桃園市大園區高鐵北路二段 147 號)

【早鳥優惠】優惠活動即日至 06.12 截止,逾期將以原價收取。(網路報名至 6/18 止)

【名額有限】即日起開放網路報名 [點我至報名系統](#)

【活動議程】

| 日期 | 場次主題 | 時間 | 議題 | 講師 |
|-------------|---------------------|-------------|----------------|----------------------|
| 6/24 (三) | S1：AI 時代下的 PCB 技術新局 | 09:00-09:10 | 貴賓引言 & 頒獎 | Intel 徐鑫洲 / 首席工程師 |
| | | 09:10-09:45 | AI 時代 PCB 產業趨勢 | 工研院產科所 張淵崧 / 經理 |

| | | | | | |
|-------------|---|-------------------------------------|--|--|--------------------|
| | | 10:00-10:40 | From Board to Breakthrough: Advanced PCB Design and Characterization for AI and Data Centers | Intel 徐鑫洲 / 首席工程師 | |
| | | 10:40-11:20 | AI Server 系統設計與製造挑戰下的 PCB 技術需求 | 廣達電腦 莊鈞涵 / 部經理 | |
| | | 11:20-12:00 | AI Server 應用下高階 PCB 技術發展 與挑戰(TBC) | 臻鼎科技控股 呂明鏞 / 處長 | |
| | S2 : 高速傳輸 挑戰下的 PCB 先進技術發展 | 13:30-13:35 | 貴賓引言 | | |
| | | 13:35-14:15 | 訊號完整性(SI)終極挑戰-迎向 1.6T 以上 高速的關鍵技術發展 | 欣興電子 陳慶盛 / 處長 | |
| | | 14:15-14:55 | 前瞻 HDI-HLC 發展趨勢 | 耀華電子 劉家霖 / 技術處處長 | |
| | | 15:10-15:50 | 超高速運算需求的先進材料趨勢 | 聯茂電子 徐紹維 / 專案副理 | |
| | | 15:50-16:30 | 高縱橫比電鍍與微盲孔填孔技術 英文演講 | Schlötter Group· Dr. Felix Goll R&D Project Manager | |
| 6/25 (四) | S3 : AI 世代下 的異質整合 矽光子 x 3DIC | 09:00-09:05 | 貴賓引言 | 台灣應用材料 藍章益 / 全球資深技 術總監 | |
| | | 09:05-09:45 | 先進封裝技術演進與應用趨勢 | Prismark 王愉博 / 首席顧問 | |
| | | 10:00-10:40 | Co-Packaged Optics Technology The Optical Interconnect Choice in the AI Era: VCSEL vs. Silicon Photonics | 瑞利光智能 何志祥 / 共同創辦人暨技術長 | |
| | | 10:40-11:20 | 矽光子發展趨勢：技術演進與製造機會 | 大同大學 張勤煜 / 助理教授 | |
| | | 11:20-12:00 | AI 趨勢下的矽光子與 3DIC 先進技術 (TBD) | 日月光集團 黃敏龍 / 資深處長 | |
| | | S4 : 先進封裝 下的玻璃基板 新戰場 | 13:30-13:35 | 貴賓引言 | 千住金屬 黃智堯 / 副總經理 |
| | 13:35-14:15 | | 大尺寸 FOPLP 製程技術 | 群創光電 林崇智 / 處長 | |
| | 14:15-14:55 | | Glass Core Substrates for CIS Packaging: Benefits, Key Challenges, and a Practical Manufacturing Path (Tentative) | Sony Shun Mitarai / Senior Process Manager | |
| | 15:10-15:50 | | Overcoming Critical Challenges in GCS for Next-gen. Chiplet and CPO | AGC · 李峻德 / 商務 開發事業部主管 | |

| | | | | |
|--|--|-------------|-------------------|--------------------|
| | | | Applications | |
| | | 15:50-16:30 | 高深寬比玻璃基板電鍍填孔及檢測技術 | 工研院機械所 黃萌祺 / 組長 |

*主辦單位保留議程變更之權利

【費用】

| 類別 | 早鳥優惠(即日起-6/12) | 定價(6/13~) | 報名費含： |
|------------------|----------------|------------|-----------------|
| 單場次方案(半日) | | | |
| 會員價 | NT\$3,500 | NT\$4,000 | 1.授權講義紙本 |
| 非會員價 | NT\$5,000 | NT\$5,500 | 2.茶水/點心 |
| 全場次方案(二日) | | | |
| 會員價 | NT\$12,000 | NT\$14,000 | 1.授權講義紙本 |
| 非會員價 | NT\$18,000 | NT\$20,000 | 2.茶水/點心 3.午餐 |

【付款方式說明】

付款可選擇信用卡線上刷卡、轉帳匯款或會員抵用券折抵。轉帳完成者請務必提供帳號後五碼至註冊聯絡窗口方便對帳。註冊窗口：黃瑜琦 mickey@tpca.org.tw

銀行：土地銀行(代碼: 005)北桃園分行
帳號：131-001-00069-9
戶名：台灣電路板協會

【先進趨勢研討會使用抵用券方式】

1. 請洽貴公司會務窗口操作並提取所需的抵用券授權碼
2. 於研討會報名頁面中輸入抵用券授權碼即可抵用

【抵用券提取方式】

1. 在協會官網中的 " 公司會籍系統" 中，輸入貴公司會務窗口專屬之帳號密碼，進行登入
2. 登入後，點選"抵用券"，"新增"輸入欲使用的金額，系統將產生授權碼，請複製授權碼。
3. 回到報名頁面，輸入抵用券授權碼即可抵用。

以上如有問題，歡迎洽詢協會窗口 <https://member.tpc.org.tw/>

【退費說明】

| 方式 | 主辦單位取消 | 報名者自行取消 (活動前三天告知) | 時間 |
|----|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 匯款 | 全額退還對方已繳費用 TPCA 需負擔匯款手續費 | 需報名者負擔 TPCA 匯款手續費後退回剩餘款項 | 以土銀匯款退費 每月 20 號前請款，月底退還 |
| 刷卡 | 刷退方式處理 | 刷退方式處理 | 確認取消後，2 日內完成刷退 |

無法退費說明:活動前兩工作天至活動當天取消且已完成繳費者，因資源已經備妥，將採會後提供講義資料，恕無法退費。

【報名窗口】

張致遠 (T) 03-3815659 #403 (F) 03-3815150 (E) matthew@tpca.org.tw
黃瑜琦 (T) 03-3815659 #405 (F) 03-3815150 (E) mickey@tpca.org.tw